# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩ 公開特許 公報 (A)

昭60—1900

⑤ Int. Cl.<sup>4</sup>
H 05 K 13/04

識別記号

庁内整理番号 6616-5F ❸公開 昭和60年(1985)1月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

### **匈認識付電子部品実装装置**

②特 願 昭58-109532

②出 願 昭58(1983)6月17日

70発 明 者 鈴木孝三

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

70発 明 者 前田嘉信

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 高田雅弘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 瀬野眞透

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

月 和 智

1、発明の名称

思識付電子部品爽裝裝置

2、特許請求の範囲

部品供給部より供給された電子部品を位置決め されたブリント基板上に実装する装置において、 装着ヘッドに保持された電子部品のセンターと製 着ヘッドのセンターとの位置観差を認識する実装 部品認識部と、前配ブリント基板上の実装部品の パターンを認識する装着ヘッドに保持された認識 邢から構成された、認識付電子部品実装装置。

3、発明の詳細な説明

庭業上の利用分野

本発明は、電子部品をブリント 茘板上に移載し、 実装する装置に関するものである。

従来例の構成とその問題点

第1図のように位置決めされたブリント 茶板 1 へ鬼子部品 2を実装するに際し、従来では第2図の如く電子部品 2のリード3に規正ツメ4a及び4b及び4c及び4dを付勢することによって電 子部品の位置規正を行っていた。

との際、規正ツメ4a及び4b及び4c及び4dの機械的なガタや電子部品2の外形寸法の大小により電子部品2を保持している装着ヘッドのセンタ 5 に電子部品2のセンタ 6 を合わせることは難しく、電子部品の高密度実装が困難であった。

また電子形品2のリード3の外形寸法の精度が 想く、リードに規正ツメを付勢して位置規正する 従来の方法では正確な位置決めは困難であった。

さらにプリント基板1の電子部品パターン7は プリント 拡板規正用基準穴 8からの寸法稍度が悪く、電子部品2を実装するに際し、やはり正確な 位盤決めが困難であった。

発明の目的

本発明は、従来の欠点であるブリント 薪板での電子部品のパターンのズレ、装着ヘッドに保持された電子部品のズレ等によりブリント 蒸板上への電子部品の正確な位置決め実装が困難という問題点をなくし、正確でしかも高密度に電子部品を実施する低子部品実装装置を提供するものである。

発明の構成

#### 突縮例の説明

以下本発明の実施例について、凹面を参照しながら説明する。

第3図は、第1図の契約例における装置全体の 平面図、第4図は同正面図を示すものであり、概略を工程順に説明する。日は搬送装置であり、プリント基板1の搬送及び位置決め保持を行う。10 は部品供給部であり、トレイ11に収められた電子部品2を装費へッド12に供給する。

第 5 図は装置ヘッド12が電子部品2をプリン ト遊板1に実装する工程を示すものである。第6 図aの如く、装着ヘッド12はトレイ11に収め られた電子部品2を保持し、第5図bの如く部品 認識装置13上まで移動する。との時、装着へっ ド12と部品認識装置14の相対位置関係は予め わかっているので、電子部品2を認識することに よって、電子部品2の方向及び電子部品2のセン タと装着ヘッド12のセンタの位置誤差等のデー メモの1を得ることができる。次に第5凶cに示 すように、装着ヘッド12に固定されたパターン 認識装置14が、プリント基板1の電子部品のパ ターンでを認識することにより、塩子部品のパタ ーンての正確な位置及び方向等のデータその2を 得ることができる。第5図dに示すように前記デ ータその1及びデータその2を基に位置及び方向 のズレを修正する方向に装着ヘッド12が移動・ 回転し、電子部品2と電子部品のパターンでのメ

レがないよう電子部品2をブリント基板1 に実装する。電子部品2を実装されたブリント基板1は 搬送装置9によって次工程に輸送される。

次化装備の詳細を工程順に説明する。

第6図は、山子部品2を装着ヘッド12に供給する工程を示したものである。低子部品2を収納したトレイ11は部品供給部10内に立統みされている。揺動レバー15によってスライド動16に沿って水平方向に移動するプッシャー17が最下段の削配トレイ11を押し出し、削記電子部品2を供着ヘッド12に供給する。

解で図さはプリント 恭板1 に前記電子部品2を、 奥装する装置の平面図であり、第で図りは側面図 である。本装置は、前記プリント 恭板1を搬送・ 位置決め保持する搬送装置 日に平行な方向に移動 可能なスライド他1 日及び駅動師1 日と前発搬送 装置 9 に適角の方向に移動可能なスライド軸2 Q 及び駅動部21 により構成されているエアテープ ル22を有し、水平面内にかける任意の移動がで まる。前記エアテープル22 に取り付けられた装 着ヘッド12は駆動部23により鉛直方向の軸まわりの回転及び鉛直方向に移動可能で、前記観子部品2をトレイ11より取り出して保持し、前記プリント艦板1上に実装する。さらにヘッド部にはパターン認識装置14が取付けられている。

第日図aは接着へッド12の配動部23の断面図、bは正面図である。第日図a)において、装着されるに面図であるとにより上下方のではいました。第日図b)において、モータ24に揺動けられた。第日図b)において、モータ27でに回定された。第日図b)において、モータ27でに回定されたであり、減速機31は4で32を配動ける。ギャルト2日間にできまれたがあり、減速機31は4で32を配動ができまれたがある。以上のよりにして接着へっド12に同じに対象によりには発音へっド12に同じに対象による。とで下頭にて電子部品2を吸着保持する。

第9回は前記部品認識装置13が装着ヘッド 12に保持された電子部品2の位置及び水平面内 の凹転角を認識する工程を示したものである。前 記部品認識装置13は、視野34及び36内のリ ード3の位置を認識することにより前記袋着へっ ド12のセンタをと前記電子部品2のセンタのと のずれ及び翡準線同志の水平面内の回転角36を 求める。第1回図は視野34内を詳細に示した図 で、37 a , b , cは電子部品2のリードである。 前記部品認識装置13はコーナーから2番目にあ る前配リード37bの先端部38a及び38bを 認識し、その中心点39bの位置を計算し、電子 部品2のセンタを求める基準点その1とする。 同様化前記視野35においても基準点その2を認 識計算し、前記基準点その1との座標の平均値を もって電子部品2のセンタeとする。同時に電子 部品2の全体の中心線の水平面内における回転角 3 日を求めることができる。さらに第10図にお けるリード37a , 370の中心点38a,39b を同様に計算し、それらの間のピッチを求め、そ

の値が定められた範囲外にあればリード不良と判断し、装着ヘッド12が不良電子部品を捨て、新たに電子部品2を保持しこれらの工程をくり返す。

第11図は前記パターン認識装置14が前記プリント基板1上の電子部品パターンでの位置と水平面内の回転角を認識する工程を示したものである。プリント携板1には、電子部品パターンでと同時に形成されたICマーク40a,40トがあり、前記パターンと認識を置14がこれらの位置を認識し、2点の中心点をもって電子部品パターンの中心点とする。またICマーク40a,40トの位置から、電子部品パターンでの中心線の水平面内の回転角が求まる。

以上のようにして求めた電子部品2の位置及び回転角のデータその1と電子部品パターンでの位置及び回転角のデータその2を基に、電子部品2と電子部品パターンでのずれが生じないように装潜へッド12が移動・回転し、電子部品2をプリント 基板1の上に高精度がつ高密度に実践する。

第12図は第2の実施例における装置全体の平

面図、第13図は毎度全体の正面図を示すものである。日は撤送毎度であり、ブリント基板の搬送及び位置供め保持を行う。41は部品供給部であり、テービングされた電子部品2を装着ヘッド12に供給する。13は電子部品認識装置、14は電子部品パターン認識袋量、22はエタテーブルである。

木-- 木-- 東施 例は、部品 供給 部 4 1 以外の 装置 及が工程 は 実施 例 その 1 と 同一 であるので、 相違 点の み 説明 する。

第14図はテーピングされた電子部品、第15 図は御品供給部の詳細図である。

第14図において、2は祖子部品、42はテープ台紙、43は粘着テーブであり、電子部品2は 粘着テープ43により台紙42に貼り付けられている。第16図において44は台紙リール、46は粘着テーブ巻き取りリール、40はパーンカセット、47はラチェットである。前記台紙42は台紙リール44に巻き取られており、先端はパーンカセット46に供給されている。前記粘磨テー ブ43は前記パーツカセット 48を通りモータ 48 化よって駆動される巻き取りリール 45 化巻 き取られる。前記パーツカセット 48 内の前記台 紙 42 は 9 チェット 47 化よって 1 ピッテブつ送 られ 装着 ヘッド 12 に前記電子部品 2を供給する。

このように本発明は、電子部品及びプリント基板のパターンの相方を認識し位置修正を行い電子 部品をプリント基板へ実装するため、高精度で実 装密度の高い電子部品実装を可能にしている。

#### 4、図面の簡単な説明

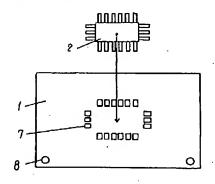
第1図は電子部品実装の概略図、第2図は従来の電子部品規正の工程図、第3図は本発明の実施例その1の実装装置の平面図、第4図は間正面図、第5図a,b,σ,dは電子部品実装の工程図、第6図は電子部品供給部の新視図、第7回はエッテーブルの平面図及び正面図、第8図a,bは装着へっドの断面図及び正面図、第9図は電子部品認識の正程図、第11図は部品パターン認識の工程図、第12図

は本発明の実施例その2の実接装置の平面図、第 13図は同正面図、第14図はテービングされた 電子部品の斜視図、第15図は部品供給部の斜視 図である。

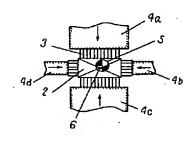
1 ……ブリント養板、2 ……電子部品、3 …… リード、7 ……電子部品パターン、9 ……搬送装 優、1 O ……部品供給部、1 2 ……装着ヘッド、 1 3 ……電子部品認識装置、1 4 ……電子部品パターン認識装置、2 2 ……エリテーブル、4 1 … …部品供給部。

. 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

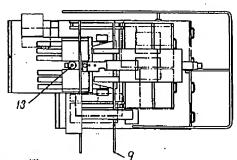
第 1 図



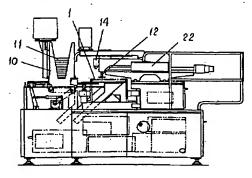
FEE 2 184



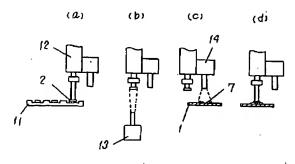
543 3 (24)



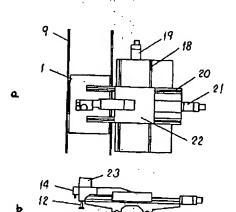
第 4 関



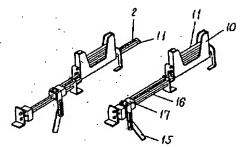
鄒 5 図



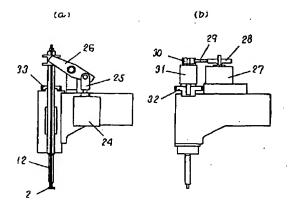
郑 7 图



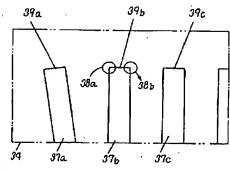
郑 6 图



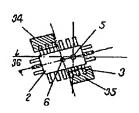
(II 8 12)



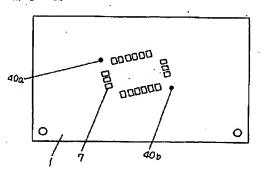
93 1 0 🖼



975 9 F81

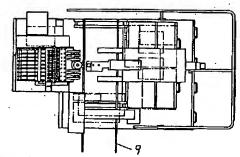


95 1 1 M



## 特開昭60-1900(8)

第12図



95 1 4 12 42 2 43

郷 13 図

